

－SEAJ装置技術ロードマップ専門委員会－

2008年度 組立WG 活動報告

・2008年度組立WG会議開催回数：4回

・会議内容

1) 後工程全体の勉強会実施 (計・・1回)

後工程における各プロセス装置の理解を深めるため、各工程のユニットについて勉強会を1回実施。今後の半導体のパッケージ動向について見識を深める。平成19年からの継続テーマ。平成21年度も引き続き勉強会実施予定。

(20年度テーマ) * モールド

(21年度テーマ) * SIP * TSV * 多層基板 等

(注) 来年度は、今回スケジュール合わず延期となった講演会を実施する。

2) 工場見学実施

住友重機械工業(株)の横須賀事業所見学。

(主な見学製品) * 造船 * 射出成型機 * モールド装置

他業種の製造現場見学を行うことができ、大変に興味深いものであった。今後の半導体製造に何らかの形で役に立てたい。

3) 来期の活動計画案纏め

来年度は、キックオフがないので、来期活動案について確認

—今後の課題—

- ・ 「ITRS」「STRJ」が発表するロードマップとの整合
- ・ 新規パッケージについて、必要となる装置の「仕様」「問題点」「その他技術的な課題」についての情報収集とその提供の仕方
- ・ 各工程装置におけるロードマップデータ整合方法
- ・ 「ITRS」のデータ開示時期の遅れに対応したロードマップ作成手順
- ・ SEAJ参画による 各委員へのメリット提供

—まとめ—

- ・ 各メンバーで知識を深めることができた。
- ・ 平成21年度の活動を行う下地ができた。
- ・ 来期、今期と同様に以下の活動を実施する。
 - * ロードマップ報告書作成
 - * 勉強会
 - * 講演会
 - * 各関係委員会の報告